证券代码：688508　　证券简称：芯朋微　　公告编号：2022-056

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯朋微"或"公司"）于 2022 年 3 月 17 日召开公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，于 2022 年 4 月 8 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的方案及相关事宜。

2022 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据相关法律法规，公司调整了本次发行募集资金总额，调整的具体内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 109,883.88 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目	39,779.57	38,428.29
2	工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目	48,819.15	47,294.66
3	苏州研发中心项目	24,644.15	24,160.93
合计		113,242.87	109,883.88

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

调整后：

本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 96,883.88 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目	39,779.57	33,928.29
2	工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目	48,819.15	42,794.66
3	苏州研发中心项目	24,644.15	20,160.93
合计		113,242.87	96,883.88

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》，本次发行方案调整事宜无需提交公司股东大会审议。

本次向特定对象发行股票方案尚待上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，最终将以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 13 日

证券代码：688508　　证券简称：芯朋微　　公告编号：2022-060

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 12 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1216 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,820 万股，募集资金总额为人民币 798,060,000.00 元，扣除发行费用人民币 75,568,924.28 元（不含税），募集资金净额为人民币 722,491,075.72 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具"苏公 W[2020]B069 号"验资报告。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的情况

根据《无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行募集资金投资项目具体如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	大功率电源管理芯片开发及产业化项目	17,566.35	17,566.35
2	工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目	15,515.14	15,515.14
3	研发中心建设项目	7,495.09	7,495.09
4	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合　计		56,576.59	56,576.59

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的基本情况

结合公司当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目预计达到可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	大功率电源管理芯片开发及产业化项目	2022 年上半年	不涉及变更
2	工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目	2022 年上半年	2022 年下半年
3	研发中心建设项目	2022 年上半年	2023 年上半年

（二）本次部分募投项目延期的原因

工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目，登记备案日期为 2019 年 9 月 30 日（锡新行审投备[2019]648 号），项目建设期为 2 年。由于受疫情影响，部分设备采购进度慢于预期，同时因产能紧张，新工艺对应的流片时间大幅度增加，导致研发进度延后，产品尚未实现大规模量产。预计 2022 年下半年工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目全部完成。

研发中心建设项目，登记备案日期为 2019 年 9 月 30 日（锡新行审投备[2019]645 号），项目建设期为 2 年。为保证营运资金充足，公司在 2020 年 7 月 22 日于科创板上市、募集资金到账后才进行募投项目的大额投入。由于实施过程中受疫情的影响，相关实验室现场基建进度落后，导致设备采购进度慢于预期、研发投入进度延后。根据设备供应商的交货周期，预计 2023 年上半年全部完成交货，届时研发中心建设项目完成。

四、本次募投项目延期对公司的影响

公司将募投项目"工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目"和"研发中心建设项目"进行延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

五、审议程序及专项意见说明

本次募投项目延期事项已经公司于 2022 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过。

（一）监事会意见

公司监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。同意前述募投项目进行延期。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。同意前述募投项目进行延期。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

（二）《国泰君安证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 13 日

证券代码：688508　　证券简称：芯朋微　　公告编号：2022-057

无锡芯朋微电子股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 12 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。

《无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 13 日

证券代码：688508　　证券简称：芯朋微　　公告编号：2022-058

无锡芯朋微电子股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯朋微"或"公司"）于 2022 年 3 月 17 日召开公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，于 2022 年 4 月 8 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》。

2022 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订的具体内容如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
特别提示	特别提示	更新了本次向特定对象发行 A 股股票的审批情况
		调整了本次发行股份数量的表述
		调整了本次发行募集资金总额与各募投项目拟使用募集资金金额
释义	释义	本预案指"无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）"
		报告期新增 2022 年 1-3 月
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	三、本次向特定对象发行股票方案概要	调整了本次发行股份数量的表述
		调整了本次发行募集资金总额与各募投项目拟使用募集资金金额
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据公司最新总股本情况，更新了张立新持股比例和发行后股份上限
	六、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次向特定对象发行 A 股股票的审批情况
第二节 本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调整了本次发行募集资金总额与各募投项目拟使用募集资金金额
		更新了公司的研发实力相关数据至报告期末
		更新了本次发行三个募集资金投资项目的投资概算、项目选址、建设期限、项目备案、环评程序等情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构的变化情况	根据公司最新总股本情况，更新了张立新持股比例和发行后股份上限
	六、本次股票发行相关风险说明	更新了本次发行的审批风险
		更新了公司供应商集中度较高风险
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况	更新了公司 2021 年度利润分配情况
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算	更新了本次发行募集资金总额相关数据
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司人员、技术储备情况至报告期末

修订后的无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件。公司本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需获得上海证券交易所的审核通过以及中国证券监督管理委员会的同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 13 日

证券代码：688508　　证券简称：芯朋微　　编号：2022-059

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重大提示：

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"芯朋微"）本次向特定对象发行 A 股股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，具体措施说明如下：

一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算

（一）测算假设及前提

1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

2、不考虑本次募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

3、假设本次发行于 2022 年 9 月末完成，该预测时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会作出予以注册决定后的实际完成时间为准；

4、以公司截至 2022 年 3 月 31 日的总股本 11,309.85 万股计算，本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 33,929,550 股，募集资金总额不超过 96,883.88 万元。因此，假设本次发行数量为 33,929,550 股，发行后公司总股本为 147,028,050 股，募集资金总额为 96,883.88 万元，未考虑发行费用及股票回购注销等因素的影响。本假设不对本次发行的数量、募集资金金额做出承诺，仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本次发行的实际发行股份数量、到账的募集资金规模将根据监管部门审核情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

5、根据公司披露的 2021 年年度报告，2021 年度归属于母公司股东的净利润为 20,128.09 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 15,192.19 万元。假设 2022 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较 2021 年度增长 10%、增长 20%和增长 30%三种情况测算。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2022 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成对本公司的盈利预测；

6、在预测本次发行后净资产时，不考虑除现金分红、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响，并假设 2022 年度权益分配金额与经第四次董事会第九次会议审议通过的《关于＜2021 年度利润分配预案＞的议案》金额相等；

7、假设 2022 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益 =2022 年期初归属于母公司所有者权益 +2022 年归属于普通股股东的净利润 −2021 年度现金分红额 + 本次向特定对象发行募集资金总额；

8、假设本次发行前公司总股本按照截至 2022 年 3 月 31 日公司总股本 11,309.85 万股计算，在预测期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本 113,098,500 股为基数，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形；

9、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算了本次发行对每股收益的影响，测算结果如下表所示：

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	
		发行前	发行后
假设 1：假设公司 2022 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较 2021 年度增长 10%			
普通股股数（万股）	11,309.85	11,309.85	14,702.81
期初归属于母公司的所有者权益（万元）	129,110.09	151,467.73	151,467.73
归属于普通股股东的净利润（万元）	20,128.09	22,140.90	22,140.90
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（万元）	15,192.19	16,711.40	16,711.40
本期现金分红（万元）	3,384.00	6,785.91	6,785.91
向特定对象发行增加净资产（万元）	–	–	96,883.88
期末归属于母公司的所有者权益（万元）	151,467.73	166,822.72	263,706.60
基本每股收益（元/股）	1.7844	1.9577	1.8211
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.3468	1.4776	1.3745
稀释基本每股收益（元/股）	1.7803	1.9528	1.8169
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益（元/股）	1.3438	1.4739	1.3713
加权平均净资产收益率	14.45%	13.69%	11.91%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.91%	10.33%	8.99%
假设 2：假设公司 2022 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较 2021 年度增长 20%			
普通股股数（万股）	11,309.85	11,309.85	14,702.81
期初归属于母公司的所有者权益（万元）	129,110.09	151,467.73	151,467.73
归属于普通股股东的净利润（万元）	20,128.09	24,153.71	24,153.71
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（万元）	15,192.19	18,230.62	18,230.62
本期现金分红（万元）	3,384.00	6,785.91	6,785.91
向特定对象发行增加净资产（万元）	–	–	96,883.88
期末归属于母公司的所有者权益（万元）	151,467.73	168,835.53	265,719.40
基本每股收益（元/股）	1.7844	2.1356	1.9866
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.3468	1.6119	1.4995
稀释基本每股收益（元/股）	1.7803	2.1304	1.9821
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益（元/股）	1.3438	1.6079	1.4960
加权平均净资产收益率	14.45%	14.84%	12.92%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.91%	11.20%	9.75%
假设 3：假设公司 2022 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较 2021 年度增长 30%			
普通股股数（万股）	11,309.85	11,309.85	14,702.81
期初归属于母公司的所有者权益（万元）	129,110.09	151,467.73	151,467.73
归属于普通股股东的净利润（万元）	20,128.09	26,166.52	26,166.52
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（万元）	15,192.19	19,749.84	19,749.84
本期现金分红（万元）	3,384.00	6,785.91	6,785.91
向特定对象发行增加净资产（万元）	–	–	96,883.88
期末归属于母公司的所有者权益（万元）	151,467.73	170,848.34	267,732.21
基本每股收益（元/股）	1.7844	2.3136	2.1522
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.3468	1.7463	1.6244
稀释基本每股收益（元/股）	1.7803	2.3079	2.1472
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益（元/股）	1.3438	1.7419	1.6207
加权平均净资产收益率	14.45%	15.98%	13.92%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.91%	12.06%	10.51%

二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次向特定对象发行股票募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险。

同时，在相关法律法规下，公司在测算本次向特定对象发行对即期回报的摊薄影响过程中对 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的假设分析以及为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施，并不构成公司的盈利预测，填补回报具体措施不代表对公司未来利润任何形式的保证。投资者不应据此进行投资决策，提请广大投资者注意。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

（一）满足本次募集资金投资项目的资金需求

为把握行业发展契机，丰富公司产品结构，进一步拓展公司主营业务，提升公司的盈利能力，公司拟通过本次发行募集资金用于新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目和苏州研发中心项目。

通过实施新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目，有利于公司进一步拓展公司电源管理芯片的业务范围，扩展公司电源管理芯片业务的产品结构，提升公司在电源管理芯片设计领域的竞争力；同时公司将建设苏州研发中心项目，以满足公司利用长三角集成电路企业集群优势、探索前沿技术研究的需求，持续保持公司的科创实力。

前述募集资金投资项目所需资金规模较大，若全部由公司以自有资金和债权融资投入，公司将面临较大的资金压力和偿债压力。故公司通过本次向特定对象发行股票募集资金，能够有效解决上述项目的资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。

（二）符合公司经营发展规划

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的运用符合公司战略发展方向。募集资金到位后，有助于提高公司的资本实力，增强公司的风险防范能力，提高公司的综合竞争力，提升公司在行业内的地位为公司带来新的业绩增长点。因此，本次向特定对象发行 A 股股票对公司经营发展有着积极的意义，有利于公司长期稳定的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

（三）向特定对象发行股票是公司现阶段最佳的融资方式

与股权融资相比，通过贷款融资和通过发行债券的方式进行资金筹集会为公司带来较高的财务成本。如公司通过上述两种方式进行融资，一方面会导致公司整体资产负债率上升，提高公司的财务风险，降低公司偿债能力和抗风险能力，另一方面会产生较高的利息费用，挤压降低公司整体的利润空间，不利于公司的稳健发展。公司通过股权融资可以有效降低偿债压力，有利于保障本次募投项目的顺利实施，保持公司资本结构的合理稳定。

综上，公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金具有必要性。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次募集资金投资项目为新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目和苏州研发中心项目，旨在完善市场布局、提高公司核心技术竞争力、加强项目产品线配套封测产能保障，并新建苏州研发中心以满足公司利用长三角集成电路企业集群优势、探索前沿技术研究的需求，持续保持公司的科创实力。因此，本次募集资金主要投向科技创新领域，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司通过自主培养为主、外部引进为辅的方式培养了一支具有竞争力的技术研发团队。截至 2022 年 3 月 31 日，公司拥有研发人数 218 人，占总员工数量的比例为 73.40%，其中拥有研究生学历的研发人员占总研发人员数量的比例为 31.65%，公司核心技术人员均拥有多年丰富的集成电路设计研发经验和深厚的技术背景。

2、技术储备

目前，公司建立了科技创新和知识产权管理的规范体系，在数字 / 模拟电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术，迭代开发出了 4 代核心技术平台。截至 2022 年 3 月 31 日，公司拥有 86 项已授权的国内和国际专利，100 项集成电路布图登记，15 项原始创新的核心技术，其中 5 项属国际先进技术水平，分别为智能功率器件高低压集成工艺技术、超低功耗高压启动技术、200V-1200V 螺旋形电场均衡场板的器件新结构技术、40V-1200V SmartMOS 器件过流保护技术以及 600V 高压隔离浮置栅半桥驱动技术。

3、市场储备

公司多年来专注于高压电源管理及控制领域，积累了业内领先的高压电源和驱动类芯片可靠性设计和管控经验。公司向客户整机系统提供从高压到低压的全套电源方案，在高压电源和驱动芯片领域具有国内领先的研发实力。公司在国内创先开发成功并量产了单片 700V 高低压集成开关电源芯片、1200V 高低压集成开关电源芯片、零瓦待机高低压集成开关电源芯片等产品，均获得国家 / 省部级科技奖励和国家重点新产品认定。多年积累的高压电源和驱动可靠性设计和管控能力为公司拓展下游领域、布局汽车赛道打下了坚实的基础。

从工业级产品开发经验来看，2019 年公司针对工业级通讯电源市场，开发了新一代高可靠、耐冲击、可交互的工业级电源管理芯片，为工业级通讯设备电源管理芯片领域实现进口替代、自主可控做出贡献。公司工业驱动类芯片的主打系列包括 800V 智能保护 AC-DC 电源芯片系列、1000~1200V 工业 AC-DC 电源芯片系列、零瓦待机 AC-DC 工业电源芯片系列、600V 浮置栅驱动电源芯片系列等，面向包括工控设备、电网集中器、服务器、通讯设备、电机设备等多样化的工业场景。

综上，公司本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务展开，在人员、技术、市场等方面均具有良好基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保项目的顺利实施。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，增强公司的可持续发展能力，提高对公司股东回报的能力，公司拟采取如下填补措施：

（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

公司已按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求制定了募集资金管理制度。公司将根据相关法律法规和募集资金管理制度的相关要求，规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（二）加快公司主营业务的发展，提高公司盈利能力

本次发行募集资金将主要投入新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目和苏州研发中心项目，上述募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，项目实施后，将进一步扩大公司的业务规模，提高公司的核心竞争力。本次发行募集资金到位后，公司将加快募集资金投资项目建设的推进，力争早日实现预期收益，从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

（三）完善公司治理，为企业发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，公司发展提供制度性保障。确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权、作出决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司的整体利益和股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权。

（四）完善利润分配政策，重视投资者回报

为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，公司已经制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后，公司将严格执行利润分配规定，切实保障投资者合法权益。

六、公司的董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。

为维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体如下：

（一）公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

7、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（二）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺

为确保公司本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 13 日

证券代码：688508　　证券简称：芯朋微　　公告编号：2022-061

无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议（以下简称"会议"）于 2022 年 8 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 2 日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

为推进本次公司向特定对象发行 A 股股票的工作，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案中的募集资金规模进行调整，从本次发行募集资金总额中扣除 13,000 万元，调整的具体内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 109,883.88 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目	39,779.57	38,428.29
2	工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目	48,819.15	47,294